科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年 6月 6日現在

機関番号:12601				
研究種目:基盤研究(B)				
研究期間:2009~2011				
課題番号:21360060				
研究課題名(和文) 金属/セラミック複合薄膜の三次元マイクロ・メゾ構造体の造形				
研究課題名(英文) Fabrication of Micro/Meso Scale Shell Structures of Metal/Ceramic Composite				
研究代表者				
帯川 利之(OBIKAWA TOSHIYUKI)				
東京大学・生産技術研究所・教授				
研究者番号:70134830				

研究成果の概要(和文):微細箔状素子のフレキシブルな製造方法として,金型を使用しないマ イクロインクリメンタルフォーミング技術を開発し,最小の形状寸法が50ミクロン程度のア ルミ箔の微細シェル構造を成形した.成形したアルミ箔の微細構造に,必要に応じて酸化ハフ ニウムあるいは窒化チタンのコーティングを施した後,水酸化カリウム溶液中で,成形した微 細構造部のアルミ箔のみを選択的にエッチングすることにより,セラミック薄膜のみの微細三 次元構造体を作成することができた.

研究成果の概要 (英文): Single point incremental microforming of metallic foils without using any die and mould has been developed as a flexible fabrication method of micro shell structures. The minimum size of a shell structure was 50 μ m in length. An aluminum micro shell structure was coated with hafnium oxide or titanium nitride and then, only aluminum foil of formed structures was etched selectively in a solution of potassium hydroxide to fabricate the micro shell structures of ceramics only.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2009年度	10, 300, 000	3, 090, 000	13, 390, 000
2010年度	3, 500, 000	1,050,000	4, 550, 000
2011年度	1, 300, 000	390, 000	1,690,000
年度			
年度			
総計	15, 100, 000	4, 530, 000	19, 630, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学

キーワード:機械工作・生産工学、ナノ・マイクロ工学

1. 研究開始当初の背景

近年、ミクロな機能性構造体の製作おいて、シ リコン以外の多様な材料に対する要求が高まって いる.最終的に要求される大きさは十ミクロンか らサブミリサイズで、形状も複雑なものが多い. また、量産性より機能の柔軟性を重視する分野で は、金型を用いる加工より素材への直接加工が望 まれている.こうしたことから、高能率で形状と 表面の加工制御性にすぐれた加工技術のマイクロ 化が要求されている. マイクロスケールの加工に対するこうした要求 を満たすため、レーザや集束イオンビームなどの ビーム加工、マイクロ放電加工、マイクロ切削加 工など、種々の微細加工技術が鋭意研究されてい る.しかし成形加工では原則的に型を使用するた めフレキシビリティに乏しく、またマイクロ化に 対応した微細金型の作成が隘路となっている.そ こで金型が不要で形状に対するフレキシビリティ の高い微細成形加工技術の開発が求められている.

2. 研究の目的

インクリメンタルフォーミングは、金型が不要 な塑性加工法であり、形状に対するフレキシビリ ティが高い唯一の成形加工法である.本研究では 微細な膜状立体構造の柔軟かつ迅速な加工を実現 するため、インクリメンタルフォーミングのマイ クロ化技術を確立するとともに、塑性加工の特徴 を生かし多様な膜構造の微細造形を可能とする加 工技術の開発、さらには金属/セラミック複合薄 膜構造体の造形技術の開発を目的とした.

インクリメンタルフォーミングは、一本の棒状 工具を用いるだけで、一枚のブランク材から多様 な形状を張出成形することが可能である.通常、 金型の代わりに、バッキングプレートとよばれる 板をあてがい、逐次張出し成形を行うが、微細化 においては、バッキングプレートの作製も大きな 障害である.そのため、本研究では、棒状工具以 外に何も使用しないことを条件に加工技術の開発 を実施することとした.

3. 研究の方法

金属/セラミック複合薄膜の三次元マイクロ・ メゾ構造体の造形法の概略を図1に示す.ここで は、セラミック薄膜の微細な四角錐台を造形対象 としている.最初に、マイクロインクリメンタル フォーミングによりアルミ箔上に微細な四角錐台 を造形する.次に特定のセラミックによりアルミ 箔をコーティングし、その後、アルミとセラミッ クが積層したピラミッドからアルミ箔を選択的に エッチングし、除去する.それによりピラミッド 部はセラミック、それ以外の平坦部はアルミ箔で 補強されたセラミック複合膜が完成する.



図1 金属/セラミック複合薄膜のマ イクロ・メゾ構造体の造形法

本研究で使用した加工機のひとつを図2に示す. 本機は X-Y テーブル,Z ステージ, $\theta_x-\theta_y$ ゴニ オステージ,スピンドル,工具およびブランクホ ルダーより構成される.X-Y テーブルの分解能は 0.01 μ m,最小の送り速度は0.0001 mm/s である. またZステージの分解能は0.01 μ m,ゴニオステ ージの分解能は0.001°であり,ゴニオステージは 薄膜の水平補正に用いられる.スピンドルには, 最高回転数 25000 min⁻¹ と 60000 min⁻¹ の電動式

最高回転数 25000 min⁻と 60000 min⁻の電動式 (60000 min⁻¹では冷却用にエアーを使用)の2種 類を用意した.



図 2 マイクロインクリメンタルフォ ーミング装置

工具には、図3の先端半径10 µm と100 µm の 超微粒子超硬棒を使用した.なお、半径10 µm の 工具先端は、テーパを付けて強度を高めている. 造形に用いたアルミ箔は厚さ12 µm の家庭用と厚 さ6.5 µm の業務用である.両者とも8021 相当材 (97.95+%Al, 0.15%Si, 1.2–1.7%Fe, 0.05%Cu)であ り、業務用は調質により強度と伸びの特性を改善 したものとなっている.技術資料や文献によれば、 アルミ箔の伸びは高々4%であるが、複雑な立体形 状を成形するため、50-100%の伸びを実現するこ とのできるマイクロインクリメンタルフォーミン グの成形条件を探索する.



先端半径 10 μm 図 3 マイクロ工具

箔を保持するためのブランクホルダーを図4に 示す.本研究ではバッキングプレートを使用しな いので、アルミ箔が加工力によってたわまないだ けの張力をアルミ箔に付与する必要がある.しか しアルミ箔に過大な張力を加えると成形限界が低 下し、一方、張力が弱いと箔がたわみ精度が低下 する. そこで図4のテンショナーと呼ぶ部品を考 案し, 突起部の直径が 10 μm 間隔で異なる複数の テンショナーを用意し、その中から必要十分な張 力を箔に与える最適なテンショナーを選択し使用 した. また,工具を回転することによりアルミ箔 にせん断応力を加え、箔の変形を促進することが 不可欠であるが、その際の工具と箔との界面の潤 滑に還元水を使用した. 高速で工具を回すと動圧 が発生し、接触圧力の小さいところに水が侵入し て潤滑する. その結果, 加工力が低下し, 損傷の 少ない加工が実現するものと考えられる. 微細な

加工の場合,粘度の高い加工液は微小な隙間に入りにくくなると想定されるので,水のように粘性が小さいもののほうが効果的なようである.なお, 還元水を用いずにドライで加工すると,薄膜の損傷が発生しやすく,全般的に加工が困難になる.



図4 ブランクホルダー

シングルポイント工具によるマイクロインクリ メンタルフォーミングの一例として,底辺の長さ L,高さh,対向する二等辺三角形のなす角 2 θ (以 下では, θ を半頂角と呼ぶ)のピラミッドの逐次 成形プロセスを図5に示す.ブランクの厚さは*t*, 工具の回転速度は ω ,工具が一回の加工で押し出 す高さは dz である.したがって工具が Z 方向に dzだけ移動する毎に,正方形をなす工具軌跡の一 辺は 2 $dx = 2dy = 2dz \tan \theta$ □だけ縮小する.



図 5 シングルポイント工具による逐 次成形プロセス

半頂角 θ のピラミッドが損傷なく成形された場 合,ピラミッドを構成する二等辺三角形の高さは, L/2 から(L/2)cosec θ まで増大するので,伸び(%) は, 100(cosec θ -1),伸び方向の対数ひずみは ln(cosec θ)で与えられる.そこで,成形可能な最 小の半頂角を実験により求め,計算される対数ひ ずみを,主ひずみ方向の成形限界とした.

上記の方法でピラミッド状に成形したアルミ箔 へのセラミックコーティングは,酸化ハフニウム HfO₂については高周波マグネトロンスパッタ, 窒 化チタン TiN については反応性マグネトロンスパ ッタにより行った.またコーティング時のアルミ 箔の温度はできる限り低温とし450°C に設定した. 次に,35°C の 1.94%KOH 水溶液中においてピラ ミッドの部分のアルミ箔の選択的なエッチングを 行い,セラミック薄膜のピラミッドアレイを作製 した.

4. 研究成果

最初に、メゾスケールの上限である底辺の長さ が 1.0 mm のピラミッドの成形条件について検討 した.アルミ箔の厚さは 12 μ m,工具先端半径は 100 μ m,テーブルの送り速度は 0.94 mm/s,工具 軸方向の送り dcはアルミ箔の厚さと同じ 12 μ mで ある.図6は種々の半頂角 θ と工具回転数に対し成 形を行ったときの実験結果であり、正の回転数は 右回りの回転を、負の回転数は左回りの回転を表 す.また〇と×はそれぞれピラミッドの成形が損 傷なしに行われた条件と損傷が生じた条件である. ただし、工具回転数 20,000 min⁻¹において、対数 ひずみ ln(cosec θ)で 0.7 以上の 3 つの〇とさらに その上の二つの×は、後述のように最適テーブル 送り速度を求めたときの結果である.



Tool rotational speed [rpm]

図6 成形限界に及ぼす工具回転速度の影響

工具が回転しない場合には、明確に成形限界が低下する.工具と箔の間の加工液(還元水)に工 具の回転による動圧が発生しないため、潤滑が良 好でないからである.また正回転の場合、40,000 min⁻¹以上で成形限界が低下し、正負のいずれの回 転でも毎分 60,000 min⁻¹で成形限界が大幅に低下 する.図5のように工具の軌跡が時計回りである ため、工具が正回転の場合、負の回転に比べて加 工液が加工点に届きにくい.したがって40,000 min⁻¹以上の高速回転では、加工液が工具の回転に 追随して連れ回ることが困難になり、成形限界が 低下したものと考えられる.

上記の結果より、工具回転数を 20,000 min⁻¹とし、テーブル速度を変えて成形を行い、テーブル 速度 0.47 mm/s において最小の半頂角 26°のピラミ ッドを成形することができた.図7に上記の条件 で成形した5個のピラミッド群を示す.側面の仰 角は64°で十分に高さがあり,その対数ひずみは 0.825,伸びは128%である.引張試験での箔の伸 びが約3-4%であるのに対し,マイクロインクリ メンタルフォーミングではその30倍から40倍の 伸びを実現することが明らかとなった.またバッ キングプレートがなくても造形が十分に可能であ ることが確認された.



図7 最適加工条件で加工した微小ピラミッド群

次に, 底辺の長さ 100 µm のピラミッドの成形 条件について検討した. アルミ箔の厚さは 12 μm, 工具先端半径は 10 µm である.予備実験の結果よ りテーブルの送り速度は0.30 mm/s,工具軸方向の 送りは1 μ m に設定した. 種々の半頂角 θ と工具回 転数に対し成形時の損傷の有無を判定した結果, 成形限界 ln(cosec θ□)は 3000 min⁻¹ で 0.556 (伸び は74.4%)であった.また造形の形状寸法が小さ くなると、最適な工具回転数ならびに成形限界が 減少することが分った.本実験結果に基づいて, 厚さ 6.5 µm のアルミ箔に一辺 100 µm と 50 µm の 微小ピラミッドを造形した.工具回転数は□3000 min⁻¹,送り速度は0.030 mm/s,工具先端半径は10 μm である.図8に成形した半頂角 45°のピラミッ ドの顕微鏡写真を示す.精度は多少低下するが, 微細な形状の造形が可能である.なお、本実験で は光沢のないマット面を表にして、光沢のあるブ ライト面側から加工を行っている. そのため造形 が微細になるにつれて,表面粗さが目立ってくる.



図8 底辺 100 µm (左) と 50 µm (右) の微細ピラミッドの成形

微細な自由形状として,寸法 150 μm,押出し高 さ 25 μm の文字「T」と「U」の成形を行った. そ れぞれの文字の断面は,曲線で構成されている. 使用したアルミ箔の厚みは 6.5 μm,工具先端半径 は 10 μm,工具回転数は 3000 min⁻¹,テーブル送 り速度は 0.030 mm/s,軸方向送りは 1 μm である. 図 9 にアルミ箔上に成形された「T」と「U」の顕 微鏡写真を示す.マット面の凹凸により光が散乱 するため粗さが目立つが,マット面の粗さは Ra で 0.185 μm, Rz で 0.940 μm であり,25 μm の押 出し高さと比較すれば,形状に及ぼす表面粗さの 影響は見かけほど大きくない.



図 9 微細文字「T」と「U」

もう少し大きな自由形状の成形結果を3例示す. 図 10 は寸法500 μ m, 押出し高さ144 μ m の数字 「3」と文字「D」の成形結果である.上の写真 が加工部分を鳥瞰したものであり,下は加工され た「3」と「D」の拡大写真である.字の太さは 100 μ m以下であるが,図9の約3倍の太さがある. この程度まで寸法が大きくなれば,かなり精度の よい成形が可能である.





図 10 寸法 500 µm の数字「3」と文字「D」. (上図は加工領域の全体写真)

図 11 は円錐台上に成形されたスペード状の錐 台である.円錐台の直径は1 mm であり,同一の 箔上に3個成形がされた.アルミ箔の厚さは12 μ m であり,加工条件を,工具半径 100 μ m,工具回転 数 4000 min⁻¹,テーブル速度 80 μ m/s,工具の軸方 向送り $dz = 10 \mu$ m に設定した.円錐台は,円状の 工具軌跡の半径を一定の割合で減少させることに より成形された.同様にしてスペード状の錐台で は、スペード状の工具軌跡の大きさを一定の割合 で減少させている.その結果、工具の軌跡として は単純であるが、比較的複雑な曲面の成形が実現 した.





図 11 円錐台上に成形されたスペード状の錐 台(左),工具側から見た凹状の加工面 (右)ならびに箔上に成形された3個 のオブジェクト

自由形状の最後の成形例として、長さ 1 mm, 造形高さ 230 μ m の車体を図 12 に示す. 箔の厚さ は 12 μ m,加工条件としては、工具半径 100 μ m, 工具回転数 20000 min⁻¹,テーブル速度 0.23 mm/s である. 顕微鏡写真では光によって角が強調され るため、平坦な部分が大きく窪んでいるように見 えるが、レーザ変位形で計測した断面からは、僅 かな窪みしか確認されない. なお、成形された箔 を計測のためにホルダーから取り外す際に、箔が 引っ張られたため、車体断面の下側では形が多少 崩れ、傾斜が緩やかになっている.



図 12 成形された車体とその断面形状

最後に金属/セラミック複合薄膜構造体の造形 結果を示す.図13はTiNをコーティングした後 の四角錐,三角錐の状態である.アルミニウムは 融点660°C,再結晶温度400°Cであることから, コーティング時の温度450°Cではアルミニウム の変形が生じやすく,ピラミッドの稜線には大 きな変形が見られないものの,稜線間の側面が へこんでいる.しかしコーティング膜に目に見 えるき裂や欠陥は確認されなかった.



図 13 コーティングされたピラミッドの状態

コーティングされたピラミッド(四角錐台)を 1.94%KOH水溶液中でエッチングした後の状態を, ピラミッドの上と底から観察した.図14の左右の 顕微鏡写真のコーティング材料はそれぞれTiNと HfO2であり,それぞれの上の図が上部から観察し た状態,下の図が底から観察した状態である.上 から見る限り,エッチングによるコーティングの 変化は見られない.一方,底からの観察では,ア ルミニウムと異なる色がピラミッドの裏側に出現 していることが確認される.これは成形されたピ ラミッドのアルミニウムがエッチングされ,セラ ミックが出現したことによるものである.



図 14 コーティングされたピラミッドのエッチング後の状態(上, Top view, 下, Bottom view, 左: TiN コーティング, 右: HfO₂コーティング)

コーティングされた HfO₂は光を通すので,エッ チング終了時点の状態を,光の当て方により確認 した.図15の上の図は,セラミックコーティング されたピラミッドの上側からの顕微鏡写真である. 一方,下の顕微鏡写真はアルミ箔側から光を当て コーティングされたピラミッドの上部より透過光 を観察したものである. ピラミッド部だけ光が透 過していることは明らかである. すなわち大きな ひずみを受けたピラミッド部が選択的にエッチン グされていることが,確認できる.



 図 15 コーティングされたピラミッドのエ ッチング後の状態(上:反射光による Top view,下:透過光の Top view)

以上の結果より、成形したアルミ箔を犠牲材料 として使用することによりセラミックのピラミッ ドを造形できることが明らかとなった.またピラ ミッド部のアルミ箔の選択的エッチングにより、 ピラミッド部を除けば、アルミ箔がサポート材と して機能する.図15のマイクロピラミッド群を俯 瞰した顕微鏡写真を図16に示す.ピラミッド(四 角錐台)の底辺は65 µm,高さ32 µm であった.



図 16 アルミ箔を犠牲材料にして造形した セラミック(HfO₂)薄膜の四角錐台

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下 線) 〔雑誌論文〕(計5件)

- <u>T. Obikawa</u>, T. Hakutani, T. Sekine, S. Numajiri, T. Matsumura, M. Yoshino, Single-point incremental micro-forming of thin shell products utilizing high formability, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems and Manufacturing, 査読有, Vol. 4, No. 6, 2010, pp. 1145-1156, DOI: 10.1299/jamdsm.4.1145
- ② T. Sekine, <u>T. Obikawa</u>, Single point micro incremental forming of miniature shell structures, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems and Manufacturing, 查読有, Vol. 4, No. 2, 2010, pp. 543-557,

DOI: 10.1299/jamdsm.4.543

- ③ <u>T. Obikawa</u>, S. Satou, T. Hakutani, Dieless incremental micro forming of miniature shell objects of aluminum foils, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 査読有, Vol. 49, No. 12, 2009, pp. 906-915, DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2009.07.001
 - 〔学会発表〕(計7件)
- <u>T. Obikawa</u>, N. Matsumoto, S. Togo, T. Matsumura, J. Leopold, Fabrication of Micro Pyramids of Thin Ceramic Film Utilizing Incremental Micro-Forming and Coating, THE "A" Coatings Ninth International Conference on Manufacturing Engineering Proceedings, pp. 57-64, Makedonia Palace Hotel, Thessaloniki, Greece, Oct. 3rd, 2011
- 2 <u>T. Obikawa</u>, T. Sekine, Fabrication of Miniature Shell Structures of Stainless Foil Using Single Point Incremental Micro Forming, Abstracts of the twenty second International Conference on Computer-Aided Production Engineering, Edinburgh, p. 7, Novotel Edinburgh City Centre, Edinburgh, United Kingdom, April 28th, 2011
- ③ 松本憲幸, <u>帯川利之</u>, セラミック薄膜の三次 元造形, 2010 年度精密工学会春季大会学術講 演会講演論文集, pp. 1091-1092, 埼玉大学 2010 年 3 月 18 日
- ④ T. Sekine, <u>T. Obikawa</u>, Single point micro incremental forming of miniature shell structures, Proceedings of the Fifth International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century, pp. 643-646, Osaka University, Dec. 4th, 2009.

6. 研究組織

- (1)研究代表者
 - 帯川 利之(OBIKAWA TOSHIYUKI)東京大学・生産技術研究所・教授研究者番号:70134830